

## 本期封面



2001年12期

栏目:

DOI:

论文题目: 衬底类型对粘贴芯片表面残余应力的影响

作者姓名: 孙志国 黄卫东 罗乐

工作单位: 中国科学院上海冶金研究所, 上海200051

通信作者: 罗乐

通信作者Email: [lueluo@mail.ac.cn](mailto:lueluo@mail.ac.cn)

文章摘要: 封装所导致的残余应力是电子器件封装和组装重点关注的问题. 本工作利用硅压阻传感器, 实时原位地记录了在不同基板材料(FR4和Al2O3陶瓷)上粘接剂固化过程中的应力变化和残余应力的分布状况. 研究表明, 在不同基板材料上固化时, 应力演化过程不同; Al2O3陶瓷基板上芯片的残余应力明显低于FR4基板.

关键词: 芯片粘贴, 硅压阻应力传感器

分类号: TG407

关闭